

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-208809

(43)Date of publication of application : 12.08.1997

(51)Int. Cl. C08L 83/00

C08K 3/36

C08K 9/02

H01L 23/29

H01L 23/31

(21)Application number : 08-037061 (71)Applicant : MIZUSAWA IND CHEM LTD

(22)Date of filing : 01.02.1996 (72)Inventor : SUZUKI KAZUHIKO

OGAWA HIROSHI

NAKAGAWA HIDEYUKI

(64) RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING AND MOISTURE-ABSORBING FILLER USED THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin compsn. for semiconductor sealing which contains a filler excellent in miscibility and dispersibility in a resin and excellent in water-adsorbing properties and water retention in the resin by selecting a specific amorphous silica having a fixed particle shape as the filler.

SOLUTION: This compsn. contains an epoxy resin, a hardner, and an inorg. filler in an amt. of 65-90wt.% of the compsn. At least 5wt.% of the filler is fixed-shape amorphous silica particles, pref. substantially spherical particles, having an average particle size of 0.5-30 μ m, a specific surface area of 5-60m²/g, an equilibrium moisture adsorption (at 50%RH) of 5-16%, and a bulk density of 0.40-1.4g/ml. Further pref. the particles contain U and Th each in a concn. of 1ppb or lower and have such adsorption characteristics that the amt. of water adsorbed reaches the equilibrium within 50hr at 50%RH.

LEGAL STATUS [Date of request for examination] 01.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal] of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3471514

[Date of registration] 12.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-208809

(43) 公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 L 63/00	NKX		C 0 8 L 63/00	NKX
C 0 8 K 3/38			C 0 8 K 3/38	
	NLD		9/02	NLD
H 0 1 L 23/29			H 0 1 L 23/30	R
23/31				
審査請求 未請求 請求項の数13 F D (全 13 頁)				

(21) 出願番号 特開平8-37081

(22) 出願日 平成8年(1996)2月1日

(71) 出願人 000193601

水澤化学工業株式会社

東京都中央区日本橋室町4丁目1番21号

(72) 発明者 鈴木 一彦

東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号

水澤化学工業株式会社内

(72) 発明者 小川 寛

東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号

水澤化学工業株式会社内

(72) 発明者 中川 英之

東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号

水澤化学工業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 鈴木 郁男

(54) 【発明の名称】 半導体封止用樹脂組成物及びそれに用いる吸湿性充填剤

(57) 【要約】

【課題】 水分吸着性及び保持性とその持続性に優れ且つ配合性及成形性にも優れたエポキシ樹脂系の半導体封止用樹脂組成物及びそれに用いる非晶質シリカ定形粒子から成る吸湿性充填剤を提供する。

【解決手段】 エポキシ樹脂系半導体封止用樹脂組成物における特定無機充填剤が、平均粒径0.5乃至30 μ m、比表面積5乃至60m²/gで、嵩密度が0.4乃至1.4g/mlで、RH50%での平衡水分吸湿量が5乃至15%で且つRH50%での平衡水分吸着時間が60時間以内である吸湿特性を有する特に球状粒子であることを特徴とする非晶質シリカ定形粒子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂と硬化剤と無機充填剤とを含有するエポキシ樹脂組成物であって、無機充填剤の少なくとも一部として、平均粒径0.5～30 μ m、比表面積5～60m²/g、平衡水分吸湿量(RH50%)5～15%及び嵩密度0.40～1.4g/mlの非晶質シリカ系定形粒子を含有することを特徴とする半導体封止用樹脂組成物。

【請求項2】 前記シリカ系定形粒子は各々1ppb以下のU及びTh含有量を有することを特徴とする請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項3】 前記シリカ系定形粒子は、RH50%での水分吸着量が50時間以内で平衡となる吸着特性を有する請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項4】 前記シリカ系定形粒子が実質上球状粒子である請求項1乃至3の何れかに記載の樹脂組成物。

【請求項5】 前記シリカ系定形粒子が多孔質の非晶質シリカ系定形粒子を、その粒子形状が壊れないように300～1300℃の温度で焼成することにより得られたものである請求項1乃至4の何れかに記載の樹脂組成物。

【請求項6】 前記シリカ系定形粒子が多孔質の非晶質シリカ系定形粒子にアルカリ金属成分乃至アルカリ土類金属成分を5重量%以下添着し、次いで乾燥乃至300～1300℃の温度で焼成することにより得られたものである請求項1乃至4の何れかに記載の樹脂組成物。

【請求項7】 前記無機充填剤が組成物当り65乃至90重量%含有され且つ無機充填剤の少なくとも5重量%以上が非晶質シリカ系定形粒子から成ることを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載の樹脂組成物。

【請求項8】 平均粒径0.5～30 μ m、比表面積5～60m²/g、平衡水分吸湿量(RH50%)5～15%及び嵩密度0.40～1.4g/mlの非晶質シリカ系定形粒子から成ることを特徴とする半導体封止用吸湿性充填剤。

【請求項9】 前記シリカ系定形粒子は各々1ppb以下のU及びTh含有量を有することを特徴とする請求項8記載の吸湿性充填剤。

【請求項10】 前記シリカ系定形粒子は、RH50%での水分吸着量が50時間以内で平衡となる吸着特性を有する請求項8または9記載の吸湿性充填剤。

【請求項11】 前記シリカ系定形粒子が実質上球状粒子である請求項8乃至10の何れかに記載の吸湿性充填剤。

【請求項12】 前記シリカ系定形粒子が多孔質の非晶質シリカ系定形粒子を、その粒子形状が壊れないように300～1300℃の温度で焼成することにより得られたものである請求項8乃至11の何れかに記載の吸湿性充填剤。

【請求項13】 前記シリカ系定形粒子が多孔質の非晶

質シリカ系定形粒子にアルカリ金属成分乃至アルカリ土類金属成分を5重量%以下添着し、次いで乾燥乃至300～1300℃の温度で焼成することにより得られたものである請求項8乃至11の何れかに記載の吸湿性充填剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、非晶質シリカ系定形粒子を配合した半導体封止用樹脂組成物及びそれに用いる吸湿性充填剤に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、トランジスタ、IC、LSI等の半導体素子の封止には、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機充填剤を含有する樹脂組成物が広く使用されている。半導体封止材料としてエポキシ樹脂組成物を使用する理由は、この樹脂組成物が電気的特性、耐湿性、耐熱性、機械的特性、他の部品との接着性等に優れていることによるが、エポキシ樹脂等を増量し、機械的強度を高め、耐熱性、耐湿性等を向上させるため、球状シリカ等の無機充填剤を配合することが広く行われている(例えば、特開平3-209747号、特開平5-217702号、特開平7-161879号公報参照)。

【0003】しかしながら、従来公知のエポキシ樹脂、硬化剤及び無機充填剤を含有する組成物から成る半導体封止材料は、これを用いた半導体装置のハンダ付け等に際し、クラックを発生したり或いはその後の経時により電気特性の劣化を来す等の問題を有している。

【0004】即ち、エポキシ樹脂は、耐湿性に優れた樹脂であるといっても、親水性の官能基を有しているため、若干の吸湿性を有している。また、エポキシ樹脂に配合する無機充填剤の多くの表面活性があり、その内部乃至表面に若干とは置え水分を吸着している。

【0005】硬化したエポキシ樹脂組成物中に含まれるこれらの水分は、ハンダ付けの際曝される高温によって膨張して、樹脂部分のクラックを発生し、これにより封止状態が破壊されて、半導体装置本体への大気の影響が発生することになる。また、封止材に上記クラックが発生しない場合にも、高温によって半導体素子側に移行した水分は電極腐食による断線や水分によるリーク電流を発生させる等のトラブルの原因となる。

【0006】更に、半導体装置を小型化且つ計量化しようとする要望が大きく、このため封止材の厚みを薄くすべく努力が払われている。しかしながらこの場合、特にエポキシ樹脂中に多量の無機充填剤を配合する場合には、封止材の壁面を通して水分(湿気)が内部に透過する傾向があるが、従来の材料は湿気の遮断についても未だ十分満足できるものではなかった。

【0007】特開平1-294476号公報には、半導体の収納容器形成用の樹脂中に、シリカゲル等の乾燥剤を添加して、吸湿性を改良することが記載されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術は、半導体封止材における吸湿の問題を乾燥剤の使用により解消しようとする点で注目に値するものであるが、シリカゲル等の乾燥剤は大気中の水分を捕捉するには有効であるものの、半導体封止用樹脂組成物中の水分を長期にわたって安定且つ有効に捕捉するにはあまり有効でないことがわかった。

【0009】従って、本発明の目的は、従来のエポキシ樹脂系封止材における上記欠点が解消され、水分吸着性及び保持性と其の持続性とに優れており、樹脂組成物の配合性や成形性等にも優れている半導体封止用樹脂組成物を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、エポキシ樹脂への配合性や分散性に優れていると共に、配合樹脂の流動性にも優れており、しかも樹脂中での水分吸着性、水分保持性及びその持続性にも優れている半導体封止用の吸着性充填剤を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、エポキシ樹脂と硬化剤と無機充填剤とを含有するエポキシ樹脂組成物であって、無機充填剤の少なくとも一部として、平均粒径0.5~30 μ m、比表面積5~60m²/g、平衡水分吸湿量(RH50%)5~15%及び嵩密度0.40~1.4g/mlの非晶質シリカ系定形粒子、特に球状粒子を含有することを特徴とする半導体封止用樹脂組成物が提供される。

【0012】本発明によればまた、平均粒径0.5~30 μ m、比表面積5~60m²/g、平衡水分吸湿量(RH50%)5~15%及び嵩密度0.40~1.4g/mlの非晶質シリカ系定形粒子、特に球状粒子から成ることを特徴とする半導体封止用吸湿性充填剤が提供される。

【0013】高機能の半導体装置用の封止剤の用途には、前記シリカ系定形粒子は各々1ppb以下のU及びTh含有量を有することが好ましい。

【0014】また、前記シリカ系定形粒子は、RH50%での水分吸着量が50時間以内で平衡となる吸着特性を有することが好ましい。

【0015】本発明に用いる吸湿性充填剤は、これに限定されないが、多孔質の非晶質シリカ系定形粒子、特に比表面積が400m²/g以上及び細孔容積が0.10ml/g以上の粒子を、その粒子形状が損われないように300~1300℃に焼成するか、或いは上記多孔質の非晶質シリカ系定形粒子にアルカリ金属成分乃至アルカリ土類金属成分を5重量%以下添着し、次いで乾燥乃至300~1300℃の温度で焼成することにより得られる。

【0016】本発明の樹脂組成物には、組成物当り65乃至90重量%の無機充填剤が含有され且つ無機充填剤

の少なくとも5重量%、特に20乃至85重量%を非晶質シリカ系定形粒子が占めていることが望ましい。

【0017】

【発明の実施形態】半導体封止用のエポキシ樹脂組成物中の水分を有効に捕捉するには、従来乾燥剤としてはシリカゲルのような比表面積の大きな非晶質シリカが使用されていたという事実からは全く意外なことに、シリカゲルよりもむしろ比表面積のかなり小さくしかも一定範囲の平衡水分吸湿量(RH50%)を有する非晶質シリカ系定形粒子が有効であることを見いだした。

【0018】即ち、本発明で使用する吸湿性充填剤は、0.5~30 μ m、特に1~10 μ mの平均粒径(電子顕微鏡観察による数平均粒径)と、5~60m²/g、特に10~50m²/gの比表面積(BET法)と、5~15%、特に7~13%の平衡水分吸湿量(RH50%)と、0.40~1.4g/ml、特に0.5~1.3g/mlの嵩密度とを有する非晶質シリカ系定形粒子から成ることが特徴である。

【0019】本明細書において、定形とは不定形に対応する用語であり、粒子の形状が互いに相似形で一定していることを意味しており、例えば球状粒子の場合は、実質上全ての粒子が球状であることを意味している。これは、球状以外の粒子、例えば立方体、六角板状、六角柱状、八面体、十二面体、二十四面体、三十二面体等の多面体においても同様である。

【0020】本発明の非晶質シリカ系定形粒子では、平均粒径が0.5~30 μ mと比較的緻細な範囲にありながら、その形状が定形粒子に制御されていることが一つの特徴である。即ち、一般に非晶質の無機粒子は、定形粒子構造をとるのが難しく、また粒径が緻細になればなる程粒子間の凝集傾向も著しく強くなる傾向があるが、本発明に用いる微粒子吸湿性充填剤では、明確な定形粒子形状と、個々の粒子が独立した微細粒子径とを維持している。

【0021】添付図面の図1は、本発明に用いる非晶質シリカ系定形球状粒子の一例の走査型電子顕微鏡写真(倍率10,000倍)であり、上記事実を明確に示している。

【0022】一方、図2は上記非晶質シリカ系定形粒子のX線回折像であり、シリカ或いはケイ酸塩に特有の回折ピークは一切観測されず、非晶質であることを示している。

【0023】この非晶質シリカ系定形粒子は、前述した0.5乃至30 μ mの粒径を有することも重要である。即ち、この粒子の粒径が前記範囲よりも小さいと、吸湿性には問題はないが、樹脂への配合作業性が低下し、また配合樹脂組成物の粘度が高くなりすぎて成形性や接着性が低下するので好ましくなく、一方上記範囲よりも大きいと、吸湿速度が小さくなるため好ましくない。

【0024】本発明に用いる非晶質シリカ系定形粒子

は、粒径が均一であり、著しくシャープな粒度分布を有している。粒度分布は、一般にコールターカウンターによる体積基準の粒径分布として求められ、その表現には種々の形式があるが、一般には大粒径側からの積算値25%に対応する粒径(D25)と積算値75%に対応する粒径(D75)との比で表わすことができる。本発明に用いる非晶質シリカ系定形粒子のD25/D75の値は一般に2以下、特に1.7以下である。

【0025】本発明に用いる非晶質シリカ定形粒子では、比表面積が、非晶質シリカとしては例外的に低い値、即ち5~60m²/gと比較的低い範囲に抑制され、しかも嵩密度が0.40~1.4g/mlと高い値に維持されているが、平衡水分吸湿度(RH50%)が5~15%と比較的大きな値を維持していることが顕著な特徴である。

【0026】即ち、上記比表面積と平衡水分量とが上記範囲内にあるということは次のことを物語っている。即ち、非晶質シリカ中には種々のサイズの細孔が存在するが、比表面積の測定は窒素ガスの吸着によるものであり、一方平衡水分吸湿度は当然のことながら水分の吸着によるものであるから、この非晶質シリカ定形粒子では、窒素ガスの吸着サイトとなる相対的に大径の細孔は比較的小さく、一方水分の吸着サイトとなる相対的に小径の細孔は比較的多いことを意味している。また、嵩密度との関係では、前述した細孔の内でも比較的大きなもの(細孔半径500Å以上)の量やマクロポア(一般に細孔半径1000Å以上)の量を低減させるように粒子中の孔の制御を行っている。嵩密度がデンスとなり、粉体としての取扱いが容易となり、エポキシ樹脂への配合や分散が容易となるという利点が得られる。

【0027】本発明で用いる吸湿性充填剤は、5~15%の平衡水分吸湿度を有することが水分吸着性、水分保持性及びその持続性に関して重要である。即ち、上記平衡吸湿度が5%未満では、吸湿できる容量そのものが不十分であり、一方、15%を越えると吸湿性充填剤がエポキシ樹脂配合前に或いは封止材としての使用初期に水分を吸湿する傾向があって、水分吸着性の持続性が得られないと共にハンダ付等に際して加熱時に水分を放出する等の欠点がある。平衡吸湿度が5~15%の範囲にある非晶質シリカ系定形粒子は、封止材中の水分を吸着するのに最も適した吸湿速度と吸湿性の持続性とに優れており、加熱下においても水分を急激に放出することがないという特徴を有している。

【0028】添付図面の図3は、本発明の非晶質シリカ系定形粒子、シリカゲル及びゼオライトについて、RH50%における吸湿度と時間との関係をプロットしたグラフであり、カーブがフラットに飽和した量が平衡水分吸湿度である。このグラフから、ゼオライトでは吸湿の立ち上がりが大きいが直ぐに吸湿の飽和を生じ、一方シ

リカゲルでは吸湿速度が遅いのに対して、本発明の非晶質シリカ系定形粒子はそれらの中間の吸湿特性を示すことが了解される。

【0029】本発明で用いるシリカ系定形粒子は、RH50%での水分吸着量が50時間以内、特に10乃至60時間で平衡状態となる吸着特性を有することが好ましい。

【0030】また、吸湿剤としての特性と充填剤としての特性を具備するためには、嵩密度が0.40~1.4g/mlの範囲にあることが重要である。即ち、嵩密度が上記範囲よりも低い場合には、充填剤としての粒子強度、顔料性(配合性、分散性)等が低下し、また上記範囲よりも大きいと、吸湿性能等が劣るようになる。

【0031】更に、比表面積が5~60m²/gにあることが、吸湿速度を最適範囲に維持する上で重要である。比表面積が60m²/gを越え、吸湿速度が大きくなりすぎ、吸湿性能の持続性に欠けるようになり、一方比表面積が5m²/gを下回ると、吸着速度が小さすぎて、やはり吸湿性能に劣るようになる。

【0032】[吸湿性充填剤] 本発明に用いる吸湿性充填剤は、上記の特性を有するものである限り全て使用できるが、好適には、多孔質の非晶質シリカ系定形粒子、特に比表面積が400m²/g以上及び細孔容積が0.10ml/g以上の粒子を、その粒子形状が壊れないように300~1300℃に焼成するか、或いは上記多孔質の非晶質シリカ系定形粒子にアルカリ金属成分乃至アルカリ土類金属成分を5重量%以下添着し、次いで乾燥乃至300~1300℃の温度で焼成することにより得られる。即ち、上記の焼成或いはアルカリ処理により、細孔の制御が有効に行われる。

【0033】原料として使用する多孔質の非晶質シリカ系定形粒子は、後述するゼオライトの酸処理による方法、シリカ微粒子の凝集成長法、シリカゲル微粒子分散液の造粒法等により得られる。

【0034】(1)ゼオライトの酸処理

多孔質の非晶質シリカ系定形粒子は、定形の粒子形態を有する結晶性ゼオライトを、その結晶構造が実質的に破壊されるが、その粒子形態が実質上壊れない条件下に酸で中和して、該ゼオライト中のアルカリ金属分及びアルミニウム分を除去することにより製造される。

【0035】原料の結晶性ゼオライトとしては、合成及び入手の容易さ、並びに処理の容易さの点から、ゼオライトA、ゼオライトX、ゼオライトY、ゼオライトP₆、アナルサイム等が使用される。ゼオライトAからは立方体状、ゼオライトP₆からは球状、アナルサイムからは24面体状の定形粒子が得られる。球状粒子を得るという目的には、ゼオライトP₆がまた多面体粒子としては24面体のアナルサイムが好適である。

【0036】用いる酸は、無機酸でも有機酸でも格別の制限なしに使用されるが、経済的には、塩酸、硫酸、硝

酸、リン酸等の酸が使用される。これらの酸は、稀釈水溶液の形で結晶性ゼオライトとの中和反応に用いる。

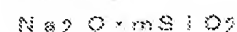
【0037】結晶ゼオライトの水性スラリーに酸を添加すると、酸の添加につれてpHは当然酸性側に移行するが、添加終了後、液のpHは再びアルカリ側に移行し、一定のpH値に飽和する傾向がある。この飽和するpH、即ち安定時pHが7.0乃至3.0、特に6.5乃至4.0の範囲となるように中和を行うことが、粒子形状を揃えることなく、ゼオライトを非晶質化するために好ましい。次いで、水洗・乾燥後焼成し、 Na_2O 、 Al_2O_3 に対し等モル以上の酸で処理する。

【0038】酸処理によりアルカリ分及びアルミニウム分を溶出除去されることにより得られる非晶質アルミナ-シリカ粒子は、濾過し、必要により水洗し、乾燥し、前記処理に用いる。

【0039】(2)凝集成長法

多孔質の非晶質シリカ系定形粒子はまた、ケイ酸アルカリ水溶液、水溶性有機高分子及び部分中和量の酸水溶液を混合し、この混合液を放置してケイ酸アルカリの部分中和物から成る粒状物を生成させ、この粒状物を分離した後、酸で中和することによっても得られる。なおこの球状シリカ粒子は、水淨化学工業(株)製の商品名ミズパールとして容易に入手されるものである。

【0040】原料として用いるケイ酸アルカリとしては、下記式



式中、 m は1乃至4の数、特に2.5乃至3.5の数である。の組成を有するケイ酸アルカリ、特にケイ酸ナトリウム水溶液を使用する。このケイ酸アルカリの組成は、混合液の安定性と生成する粒状物の収率及び粒子サイズとに關係している。

【0041】ケイ酸アルカリの濃度は、混合液中での SiO_2 としての濃度が3乃至10重量%、特に4乃至8重量%の範囲となるようにするのがよい。

【0042】この方法では、微粒子シリカの凝集成長剤として、水溶性高分子を使用する。凝集成長剤としては、カルボキシメチルセルロース(CMC)が最も好適であるが、他にアクリルアミド系重合体や、他の水溶性高分子も使用できる。凝集成長剤は、ケイ酸アルカリ溶液中の全シリカ当り、 SiO_2 重量基準で1乃至100%、特に5乃至50重量%となる量で使用する。

【0043】この方法では、CMCと組み合わせで、水溶性無機電解質或いは他の水溶性高分子から成る凝集成長助剤を使用することもできる。水溶性無機電解質としては、水溶性であって、ゾル等に対して凝集作用を有する無機の電解質であれば任意のものを使用することができるが、周期律表第1族、第2族、第3族、第4族金属或いは他の遷移金属の硫酸塩或いは有機酸塩が使用され、その適当な例は次の通りである。

【0044】アルカリ金属塩、例えば NaCl 、 Na_2

SO_4 等のアルカリ金属の硫酸塩；アルカリ土類金属塩、例えば塩化カルシウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、硝酸カルシウム等の硫酸塩；塩化亜鉛、硫酸亜鉛、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、硫酸チタン等の他の水溶性金属塩。

【0045】また、凝集成長剤或いは凝集成長助剤として、他の水溶性高分子を使用することもでき、この目的に、CMCとの相溶性が良い、澱粉、グアーガム、ローカストビーンガム、アラビアガム、トラガントガム、ブリテイシュガム、クリスタルガム、セネガールガム、PVA、メチルセルロース、ポリアクリル酸ソーダ、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、ポリエチレングリコール、等のノニオン系の高分子を使用することもできる。

【0046】中和に用いる酸としては、種々の無機酸や有機酸が使用されるが、経済的見地からは、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸等の鉱酸を用いるのがよく、これらの内でも、粒状物の収率や、粒径及び形態のバラツキの面で硫酸が最も優れている。均質な反応を行うためには、希釈水溶液の形で用いるのがよく、一般に1乃至15重量%の濃度で使用するがよい。更にこれらの酸には NaCl 等の水溶性電解質、特に酸性塩、中性塩を加えておいてもよい。混合に際しても使用する酸の量は部分中和により均質な混合溶液(透明である)を生成するようなものであり、混合液のpHが10.2乃至11.2、特に10.5乃至11.0となるような量で用いるのがよい。

【0047】この方法では、上記各成分の添加順序には制限がなく、例えばケイ酸アルカリ水溶液に酸を加えた後、凝集成長剤を加えてもよく、また逆にケイ酸アルカリ水溶液に凝集成長剤を加えた後、酸を加えてもよい。これらを同時に加えてもよいことは当然である。凝集成長助剤を用いる場合には、この凝集成長助剤は、各成分を添加するための水性媒体として用いてもよく、或いは酸中に予め添加しておいてもよい。各成分を十分混合して、均質化させた後、この混合液を静置して部分中和物の粒状物を析出させる。

【0048】この析出条件としては、一般に0乃至100℃好適には10乃至40℃の温度で1乃至50時間好適に3乃至20時間程度の放置が適している。一般に温度が低い程、析出粒子の粒径が大きくなり、温度が高い程析出粒子の粒径が小さくなる。かくして温度の制御により、粒状物の粒径を制御しうる。析出した粒子と母液とを分離し、水に再分散した粒子は、酸を加え中和した後、水洗、乾燥、分級等の操作を行って前述した処理用の原料とする。分離した母液や中和後の分散液には未析出のシリカ分や、凝集成長剤が含有されているので、これらは次の混合析出に有効に再利用できることになる。

【0049】また必要に応じて、混合液に、粒径が微細な任意のシリカゾル、シリカゲルまたは無水シリカ粉末

を核剤或いは増量剤として、シリカ全重量当り SiO_2 基準で前述した量で予め添加しておくことも出来る。用いるシリカはサブミクロンの粒径を有することが好ましい。

【0050】(3) シリカゲル微粒子分散液の造粒法
また、多孔質の非晶質シリカ系定形粒子は、ケイ酸アルカリ溶液と鉍酸とを同時に混合してゾルを形成させ、形成されるゾルを気体媒体中に放出させてゲルを形成させるに際し、ケイ酸アルカリ溶液或いは鉍酸の少なくとも一方に水不溶性固体粒子をマクロポア増進剤として分散させることによって製造される。

【0051】ケイ酸アルカリとしては、前述した組成を有するケイ酸アルカリ、特にケイ酸ナトリウムの水溶液を使用する。

【0052】ケイ酸アルカリの濃度は、 SiO_2 基準で100乃至225g/lの濃度、特に130乃至150g/lの濃度を有するものが好適である。

【0053】酸としては、種々の無機酸や有機酸が使用されるが、経済的に見れば、硫酸、塩酸、硝酸、りん酸等の鉍酸を用いるのがよく、これらの内でも、球状シリカゲルの性能、粒径及び形態の一致の点で硫酸が最も優れている。均質な反応を行うためには、希釈水溶液の形で用いるのがよく、一般に1乃至15重量%の濃度で使用するのがよい。

【0054】ケイ酸アルカリ或いは酸に添加する固体粒子としては、水不溶性で水性媒体になじみ(親和性)があり且つ安定であるものであれば、無機のものでも有機のものでも広く使用しうるが、一般には無機のもの好ましい。

【0055】無機の固体粒子として、周期律表第IIA族、第IVA族、第IVB族、第VB族、或いは第VIII族元素の酸化物、複合酸化物、水酸化物、または複合水酸化物を挙げることができる。具体的には、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化鉄、酸化コバルト、酸化ニッケル、酸化パラジウム、酸化白金、ケイ酸ジルコニウム等が挙げられる。

【0056】これらの内でも、シリカ、アルミナ、チタニアまたはジルコニアが好適なものであり、特にシリカとしては非晶質シリカ、アルミナとしてはギブサイト型水酸化アルミニウム、擬ペーサイト型アルミナゲル等の比表面積が $50\text{m}^2/\text{g}$ 以上のものが有利に使用される。

【0057】また、無機の固体粒子としては、テクトアルミノケイ酸塩或いはフィロアルミノケイ酸塩、特に天然または合成の粘土或いはゼオライトを用いることができる。粘土鉱物としては、モンモリロナイト、バイデライト、ノントロナイト、サボナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、ハロイサイト、パイロフィライト、カオリナイト、アンチゴライト、セピオライト、パリゴルスカ

イト、バーミキュライト等を挙げることができる。ゼオライトとしては、A型、X型、Y型、P型の各種ゼオライト、モルデナイト、シリカライト、ZSM-5等を挙げることができる。また、これらの酸処理物や焼成品を用いることもでき、更に、固体粒子として、活性炭を用いることもできる。

【0058】固体粒子が0.01乃至 $15\mu\text{m}$ の平均粒径、特に0.1~ $2\mu\text{m}$ の平均粒径を有する粒子であるのが好ましい。

【0059】固体粒子は、ケイ酸アルカリ溶液に分散させても、鉍酸に分散させてもよく、アルカリに安定な固体粒子、例えば水酸化アルミニウムはケイ酸アルカリに加えるのがよく、一方酸に安定な固体粒子、例えば非晶質シリカは鉍酸に加えるのがよい。

【0060】固体粒子(SP)は、ケイ酸アルカリ中のシリカ(SiO_2)基準で、 $\text{SiO}_2:\text{SP}=95:5$ 乃至 $55:45$ 、特に $85:15$ 乃至 $70:30$ の重量比となる量で用いるのがよい。

【0061】また、固体粒子を分散させたケイ酸アルカリ溶液或いは鉍酸は、20センチポイズ以下の粘度を有するべきであり、上記粘度に維持することにより、ケイ酸アルカリと鉍酸との混合を極めて短時間の内にしかも均一に行うことができる。

【0062】この方法では、このように製造した、少なくとも一方に固体粒子が添加されたケイ酸アルカリと鉍酸とを二流体ノズルに供給し、両者を同時に混合してゾルを形成させ、次いで気体媒体中に放出してゲル化させる。

【0063】二流体ノズルに対するケイ酸アルカリ及び鉍酸の供給比率は、混合時のpHが6乃至11となるようなものであるのがよく、また流量の比率は、種々変化させるが、一般に70:30乃至50:50の範囲にあるのが望ましい。

【0064】二流体ノズルとしては、内筒部と外筒部とを備え、内筒部の先に混合部及び混合部の先に吐出口があるノズルが使用され、内筒部に一方の流体を供給し、内筒部と外筒部との間の環状部に他方の流体の通路があるものが適している。内筒部及び環状部に流体を供給するには、その接線方向に流体を導入して、旋回流を生じさせることが瞬時の混合を可能にする上で好ましく、両者の旋回方向が互いに逆向きであることが最も好ましい。一般に必要なが、特公昭48-13834号公報に記載されているように旋回流発生用の案内羽根を設けることもできる。

【0065】二流体ノズルから吐出されるシリカゾルは、気体媒体中で液滴の形に保たれながらゲル化し、球状のシリカヒドロゲルとなる。ノズルからのヒドロゾルの吐出は、任意の方向に行ってもよく、例えば円錐状に下向きに行ってもよく、また上向き或いは横向きに行ってもよい。

【0066】シリカヒドロゲルの落下方向には、水性媒体を収容したシリカヒドロゲルの受け貯槽を設けるのがよい。この受け貯槽では、シリカヒドロゲルの熟成或いは脱アルカリ等を行わせることが好ましい。

【0067】一般に、受け貯槽に希アルカリ水溶液を張り込んでおくと、シリカヒドロゲルを破砕することなく回収できると共に、これを熟成することによって、性能及び形状の安定したシリカゲルを得ることができる。熟成処理は、40乃至15℃の温度で4乃至16時間程度が適当である。

【0068】熟成処理を終えたシリカヒドロゲルは、ゲル中に残留するアルカリ分を除くために、酸処理による脱アルカリ処理に付するのがよい。この脱アルカリ処理は、pH1乃至3、5の酸水溶液を使用して、40乃至15℃の温度で8乃至24時間程度の処理が適当である。

【0069】これらの処理を終えたシリカゲルは洗浄処理に付する。洗浄処理は、流水を使用して、pHが7.5±0.1の範囲にあり、且つ伝導度が50mSの範囲となるようにするのがよい。

【0070】最後に得られたシリカゲルを乾燥して、シリカのキセロゲルとする。この乾燥は、80乃至200℃の温度で、12乃至48時間程度行うのが好ましい。乾燥は、水蒸気存在下に、所謂蒸し乾燥として行うこともできる。

【0071】上記のようにして得られる多孔質の非晶質シリカ系定形粒子の焼成処理は、300乃至1300℃の温度で行うが、この焼成の具体的条件は、非晶質シリカ系定形粒子が前述した物性を有するような細孔の制御が行われるように定める。勿論この焼成条件は粒子形状の破壊を招くものであってはならない。

【0072】一般的にいつて、焼成温度が高くなるほど、また同じ温度では焼成時間が長くなるほど、細孔の収縮の程度は大きくなる。かくして、原料が有する比表面積及び細孔容積と、所望とする比表面積及び平衡水分吸湿量（RH50%）との兼ね合いで焼成条件を決定すればよい。

【0073】また、多孔質の非晶質シリカ系定形粒子に、アルカリ金属成分又はアルカリ土類金属成分を添着させることも、該粒子中の細孔を収縮させて、非晶質シリカ系定形粒子が前述した物性を有するように細孔の制御を行うのに有効である。

【0074】アルカリ金属分やアルカリ土類金属分は、吸湿性を損なわない範囲の量で用いるべきであり、一般に多孔質の非晶質シリカ系定形粒子に対して、酸化物基準で5重量%以下、特に2重量%以下の量で用いるべきである。アルカリ金属分やアルカリ土類金属分を1重量%以上で用いると、焼成を行わない場合にも所望の細孔の制御が行われることが了解されるべきである。勿論、細孔の制御が所望の程度にまで進行していないときに

は、焼成処理を行えばよい。

【0075】本発明の吸湿性充填剤は、格別の処理を行うことなく、半導体封止用樹脂組成物中に配合できることは当然であるが、所望によっては公知の配合剤で前処理した後、樹脂組成物中に配合することができる。

【0076】例えば、粉体としての流動性や粒子の樹脂中への分散性を一層向上させるために、気相法シリカ、気相法アルミナ、気相法チタニア等の微粒子分散性向上剤を、1乃至10重量%程度の量で外添することができる。

【0077】〔エポキシ樹脂〕本発明において、エポキシ樹脂としては、従来封止材の分野に使用されているエポキシ樹脂は全て使用でき、一般に1分子中に2個以上のエポキシ基を有する樹脂が使用される。エポキシ樹脂としては、ポリグリシジルエーテル、ポリグリシジルエステル、脂環式エポキシ樹脂などの各種のものがあるが、ビスフェノールA型、ビスフェノールF型、ビスフェノールAD型、フェノールノボラック型、クレゾールノボラック型、グリシジルアミン型、多価フェノールのグリシジルエーテル及びこれらの臭素化物などが適当である。

【0078】〔硬化剤〕硬化剤としては、一般にエポキシ樹脂の硬化剤として知られているものは殆んど用いることができ、例えば、アミン類、ポリアミドアミン類、酸無水物類、ポリアミド類、ジシアジアミド等が使用できる。具体的には、アミン類としては、N-アミノエチルピペラジン、ジエチレントリアミン、トリエチレントトラミン、トリメチルヘキサメチレンジアミン、イソホロンジアミン、メタキシリレンジアミン、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン等が用いられ、酸無水物類としては、無水フタル酸、無水トリメリット酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、ドデセニル無水コハク酸、エチレングリコールビス（アンヒドロトリメリット）、無水マレイン酸等が用いられる。

【0079】〔充填剤〕本発明においては、上記吸湿性充填剤を、単独で充填剤として使用することもできるし、他の充填剤と組み合わせて使用することもできる。他の充填剤としては、結晶性シリカ、溶融シリカ、アルミナ、アタパルガイド、カオリン、カーボンブラック、グラファイト、微粉ケイ酸、ケイ酸カルシウム、ケイソウ土、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、スレート粉、セリサイト、フリント、炭酸カルシウム、タルク、長石粉、二硫化モリブデン、バライト、ひる石、ホワイティング、マイカ、ろう石クレイ、石こう、炭化ケイ素、ジルコン、ガラスビーズ、シラスバルーン、アスベスト、ガラス繊維、カーボン繊維、ロックウール、スラグウール、ボロンウスイカ、ステンレススチール繊維、チタン白、亜鉛華、ベンガラ、鉄黒、黄色酸化鉄、チタンエロー、酸化クロムグリーン、群青、紺青等が挙げられる。

【0080】〔配合処方〕本発明の封止材組成物において、前記硬化剤はエポキシ樹脂を硬化させるに十分な量で使用され、一般にエポキシ樹脂に含まれるエポキシ基1当量に対して、硬化剤中のエポキシ基と反応する官能基が0.6～1.4当量、好ましくは0.8～1.2当量となるような量で用いられる。

【0081】一方、無機充填剤は、組成物全体当たり65乃至90重量%、特に75乃至90重量%を占めるように配合するのがよく、本発明による吸湿性充填剤は無機充填剤の少なくとも5重量%を占めるように配合するのがよく、勿論無機充填剤の全量が吸湿性充填剤であっても、一部が吸湿性充填剤であってもよい。

【0082】本発明の半導体封止用樹脂組成物には、それ自体公知の樹脂配合剤を配合することができ、例えば、(イ)天然または合成パラフィン、マイクロワックス、ポリエチレンワックス、塩素化ポリエチレンワックス等の炭化水素系のもの、(ロ)ステアリン酸、ラウリン酸等の脂肪酸系のもの、(ハ)ステアリン酸アミド、パルミチン酸アミド、オレイン酸アミド、エシル酸アミド、メチレンビスステアロアミド、エチレンビスステアロアミド等の脂肪酸モノアミド系またはビスアミド系のもの、(ニ)ブチルステアレート、硬化ヒマシ油、エチレングリコールモノステアレート等のエステル系のもの、(ホ)セチルアルコール、ステアリルアルコール等のアルコール系のもの、(ヘ)ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム等の金属石ケンおよび(ト)それらの混合系溶剤乃至離型剤や、三酸化アンチモン等の難燃剤、カーボンブラック等の顔料等をそれ自体公知の処方に従って配合することができる。

【0083】本発明の半導体封止用樹脂組成物の調製に当たっては、上述した各種成分、即ち、エポキシ樹脂、硬化剤、吸湿性充填剤或いは更に無機充填剤を配合ブレンドし、ミキサー或いはローラー等で混練して、成形用の組成物とし、これをトランジスター、IC、LSI等の半導体素子の封止用の被覆、成形モールド、収納容器(パッケージ)等の成形に用いる。勿論、本発明の半導体封止用樹脂組成物は、液体乃至半固体の形で、パッケージの容器と蓋との接着に用いることもできる。

【0084】

〔実施例〕本発明を次の例にて更に説明する。本実施例の粉末物性は以下の方法で測定した。

1. 粒径

定容型電子顕微鏡(日立製S-570)で得られた写真像から、代表的な粒子を50ヶ選んで、スケールを用いて粒子像の直径を測定し粒子径とした。

2. D_{25}/D_{75}

コールターカウンター(コールターエレクトロニクス社製TA-II型)法によりアパチャーチューブ50 μ を用いて測定し、積算値の25%の粒度値を75%の粒度値で除して求めた。

3. 比表面積、細孔容積

カルロエルバ社製Sorptomatic Series 1800を使用し、BET法により測定した。

4. 嵩密度

JIS K-6220、6.8に準拠して測定した。

5. 吸湿量

試料約1gをあらかじめ重量を測定した40×40mmの秤量ビンに入れ150℃の電気恒温乾燥器で3時間乾燥後デシケーター中で放冷する。次いで試料の重さを精秤し、あらかじめ硫酸で相対湿度50%に調整したデシケーター中に入れ72時間後の重量を測定し求めた。

6. 吸油量

JIS K 6220、6.21に準拠して求めた。

7. pH

JIS K-5101、26に準拠して求めた。

8. 屈折率

液浸法により求めた。

9. U、Thの分析

試料を硫酸、硝酸及びフッ化水素酸で分解した後、希硝酸に溶かし所定溶液とし、得られたこの溶液中のU、Thの測定をICP質量分析法で求めた。

【0085】実施例1

内容積150リットルの攪拌機付樹脂製反応容器に3N-HCl溶液75kgと水澤化学工業(株)製シルトンAMT-シリカ#100B、#300B(P α 型ゼオライト)を処理して得られる球状シリカ粒子、平均粒径1.5 μ m)及び同じくシルトンANS-200(24面体のアナルサイムを酸処理して得られる24面体シリカ粒子、平均粒径21 μ m)粉末の各10kgをそれぞれ分散させ、攪拌下に徐々に85℃に加温させ、その温度で7時間熱処理を行った。次いでこの熱処理スラリーを吸引濾過し、純水で十分洗浄後、更に同様の処理を3N-硝酸で行い純水で十分水洗、濾過させて含水ケーキ状の試料1-0(#100B)、2-0(#300B)、3-0(ANS-200)を得た。この含水ケーキの試料1-0、2-0、3-0を110℃の恒温乾燥器で乾燥後粉砕し、さらに電気炉で約900℃の温度で40分焼成して試料1-1、2-1、3-1を調製した。次に試料1-0、2-0、1-3各600gをホモミキサーで分散し濃度30%のスラリーに調整後、Na₂O量がSiO₂に対して0.8wt%になるように20%NaOH溶液を添加しさらに1時間攪拌後、150℃の電気恒温乾燥器で20時間乾燥後、サンプルミルで粉砕し、乾燥品のそれぞれ試料1-2、2-2、3-2を得た。この粉末性状を第2表に示した。次に試料1-2、2-2、3-2を630℃で1時間焼成してそれぞれ試料1-3、2-3、3-3を得た。その粉末の性状を第1表及び第2表に示した。

【0086】

〔表1〕

	試料1-0	試料2-0	試料3-0	試料1-1	試料3-1
粒 径 (μm)	1.5	3.2	2.3	1.4	3.1
D_{25}/D_{75}	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5
比表面積 (m^2/g)	600	550	480	60	55
細孔容積 (ml/g)	0.40	0.38	0.21	0.13	0.55
カク密度 (g/cm^3)	0.59	0.66	1.21	0.67	0.53
吸湿度 (NH ₃ %)	21	18	16	9.2	8.5
吸油量 ($\text{ml}/100\text{g}$)	49	26	20	36	22
pH	4.5	4.6	4.8	6.8	6.5
屈折率	1.45	—	1.45	—	1.47
MO (%)	—	—	—	—	—
C、T H 量 (ppb)	—	—	—	1>、1>	1>、1>

【0087】

【表2】

試 料 No	試料3-1	試料1-2	試料2-2	試料1-2
粒 径 (μm)	2.0	1.5	3.3	2.0
D_{25}/D_{75}	1.5	1.6	1.6	1.6
比表面積 (m^2/g)	33	42	48	33
細孔容積 (ml/g)	0.04	0.18	0.03	0.04
カク密度 (g/cm^3)	1.3	0.70	0.32	1.30
吸湿度 (NH ₃ %)	5.7	7.4	6.5	6.7
吸油量 ($\text{ml}/100\text{g}$)	17	37	30	22
pH	6.5	9.5	9.4	9.7
屈折率	1.46	1.47	1.47	—
MO (%)	—	Na ₂ O 0.8	Na ₂ O 0.5	Na ₂ O 0.3
C、T H 量 (ppb)	—	1>、1>	1>、1>	—

【0088】 実施例2

300リットルのステンレス製容器に市販3号ケイ酸ソ

ーダ (SiO_2 27.8%, Na_2O 9%, $\text{SiO}_2 / \text{Na}_2\text{O} = 3.19$) を45kg (全液量中の SiO_2 濃度として6%) と水105kgを加えた後、攪拌しながらカルボキシメチルセルロース (エーテル化度1.34、1%粘度230cp) の粉末1.63kg (水分8%) を加え充分分散後25°Cに調整する。ついで攪拌下にあらかじめ25°Cに調整した5%硫酸57.5kgをゆっくり注加し、注加終了後攪拌を止めその温度で10時間静置して本発明の前駆体である球状シリカ粒子を析出させた。次に析出した球状シリカ粒子のゲルを攪拌分散し、これに濃度14%の硫酸を41.6kg加え、1時間の脱Na処理を行った (この時のpHは1.2であった)。次にこのスラリーを吸引濾過後、純水で十分水洗し濾過ケーキをさらに2N塩酸溶液中に再分散させて十分に攪拌処理をし、同様に濾過・水洗をして粒径2.2

μm の多孔質球状シリカの含水ケーキの試料4-0を得た。この含水ケーキ (4-0) を110°Cの恒温乾燥器で乾燥後、粉碎しさらに電気炉で950°Cの温度で30分焼成して試料4-1を調整した。またこの含水ケーキ (試料4-0) を高速ホモミキサーを使用して十分分散後 (SiO_2 濃度18%)、 SiO_2 に対して Na_2O 分で0.8%になる様に10% NaOH 水 (和光純薬試薬特級を純水に溶解して調整) を加え、1時間攪拌後、そのまま150°Cの恒温乾燥器で24時間かけて乾燥後、粉碎しサンプル (試料4-2) を調整した。次いでこの粉末を800°Cで1時間焼成して、同様にサンプル (試料4-3) を調整した。各々の試料の粉末性状を第3表に示した。

【0089】

【表3】

	試料4-0	試料4-1	試料4-2	試料4-3	試料5-1
粒 径 (μm)	2.2	2.4	2.2	2.1	7.6
D_{15}/D_{75}	1.6	1.6	1.5	1.8	1.5
比表面積 (m^2/g)	740	38	60	45	40
細孔容積 (ml/g)	0.56	0.13	0.18	0.05	0.06
空隙密度 (g/cm^3)	0.56	0.58	0.48	0.57	0.75
吸 着 量 (VH5%)	1.9	6.8	13.8	6.4	7.3
吸着量 ($\text{ml}/100\text{g}$)	150	65	99	56	69
pH	4.5	6.0	8.4	8.8	7.4
屈折率	1.45	—	1.47	1.48	1.47
MO (%)	—	—	Na_2O 0.6	Na_2O 0.8	MgO 0.5
U、Th量 (ppb)	—	1>, 1>	—	1>, 1>	1>, 1>

【0090】実施例3

実施例2でCMCの量を0.89kgとし総重量は水で同量になるように調整し、さらに液温を10°Cにした以外は実施例2と同様にMgOとして0.5% (SiO_2 に対して) となるように純水で1:1に希釈したMg (NO_3) $2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (和光純薬製試薬特級) 溶液を加え、実施例2の試料4-1と同様に粉碎・乾燥・焼成して試料5-1を調整した。その粉末性状を第3表に示した。

【0091】比較例1

実施例1で Na_2O 量が6%になるように添加して乾燥

した場合は溶解 (溶融) した状態で固いブロック状になり球状粒子の原型が認められなかった。

【0092】比較例2

実施例1で焼成温度を1400°Cとしたところ球状粒子の原型は認められなく、固いブロック状になった。

【0093】実施例4~8

第4表に示した配合割合で混合、混練、粉碎して封止用エポキシ樹脂成形材料を調整したが、エポキシ樹脂としてはエポキシ当量220、軟化点80°CのビスフェノールA型エポキシ樹脂を用い、フェノール樹脂としては水酸基当量104、軟化点87°Cのノボラック型フェノー

ル樹脂を用い、シリカとしては市販品（ $8\mu\text{m}$ 、比表面積 $2\text{m}^2/\text{g}$ 以下、吸湿度 $\text{RH}50\%$ で 1% 未満）と本実施例品を添加した。次に該封止用成形材料をトランスファー成型機を用いて金型温度 175°C 、成形圧力 60

kg/cm^2 硬化時間 5 時間で素子のを封止成形した。

【0094】

【表4】

	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8
エポキシ樹脂	110	110	110	110	110
フェノール樹脂	50	50	50	50	50
トリフェニルホスフィン	3	3	3	3	3
カルテバワックス	2	2	2	2	2
シタンカップリング剤*	3	3	3	3	3
カーボンブラック	2	2	2	2	2
三酸化アンチモン	8	8	8	8	8
試料1-1	240	—	—	—	—
試料2-2	—	384	—	—	—
試料3-2	—	—	480	—	—
試料4-1	—	—	—	192	—
試料5-1	—	—	—	—	240
市販シカ($8\mu\text{m}$)	240	96	—	288	240

(*) ヤーグリスドキシプロピルトリメトキシシラン、配合は重量部数

成型性は流出バリの状態と、溶融粘度の状態で評価し、半田処理後の耐湿性の評価は 250°C の半田浴に 10 秒間浸漬し、次いで 127°C 、 2 、 5 気圧の飽和蒸気中でプレッシャー・クッカー・テスト (PCT) を行い、アルミニウム配線の腐食状態等を目視観察し、それぞれ流

出バリの流出性、粘着性、溶融粘度の均一性、発泡の有無及び耐湿性等を良、不良で評価をし、その結果を第5表に示した。

【0095】

【表5】

	流出率	熔融粘度	耐湿性 50時間	耐湿性 200時間
実施例4	良好	良好	良好	良好
実施例5	良好	良好	良好	良好
実施例6	良好	良好	良好	良好
実施例7	良好	良好	良好	良好
実施例8	良好	良好	良好	良好
比較例3	良好	良好	不良	不良
比較例4	不良	不良	不良	不良
比較例5	不可	不可	不可	不可

【0096】比較例3

実施例4でシリカを市販の不定形シリカ(8 μ m)480重量部にした以外は実施例4と同様に試験した。結果を第5表に示した。

【0097】比較例4

実施例4で試料1-1の代わりに不定形のゼオライトであるY型ゼオライト粉末(ミズカシープスY-400水澤化学社製)の110℃乾燥品を240重量部添加した以外は実施例4と同様に試験した。結果を第5表に示した。

【0098】比較例5

実施例7で試料4-1の代わりに不定形のシリカゲル粉末(粒径3 μ m、比表面積700m²/g、嵩密度0.50g/cm³)の110℃乾燥品を240重量部添加した以外は実施例4と同様に試験したが、樹脂と混合する事が不可能であった。

【0099】

【発明の効果】本発明によれば、特定の粒径、比表面積、平衡水分吸湿量(RH50%)及び嵩密度を有する非晶質シリカ系定形粒子を、半導体封止用の吸湿性充填剤として用いることにより、従来のエポキシ樹脂系封止材における前記欠点が解消され、樹脂中での水分吸着性及び保持性とその持続性に優れており、樹脂組成物の配合性や成形性等にも優れている半導体封止用樹脂組成物を提供することができた。

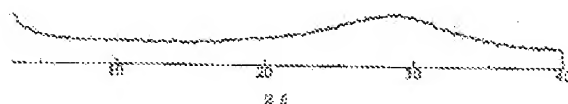
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いる非晶質シリカ系定形球状粒子の一例の走査型電子顕微鏡写真(倍率10,000倍)である。

【図2】上記非晶質シリカ系定形粒子のX線回折像である。

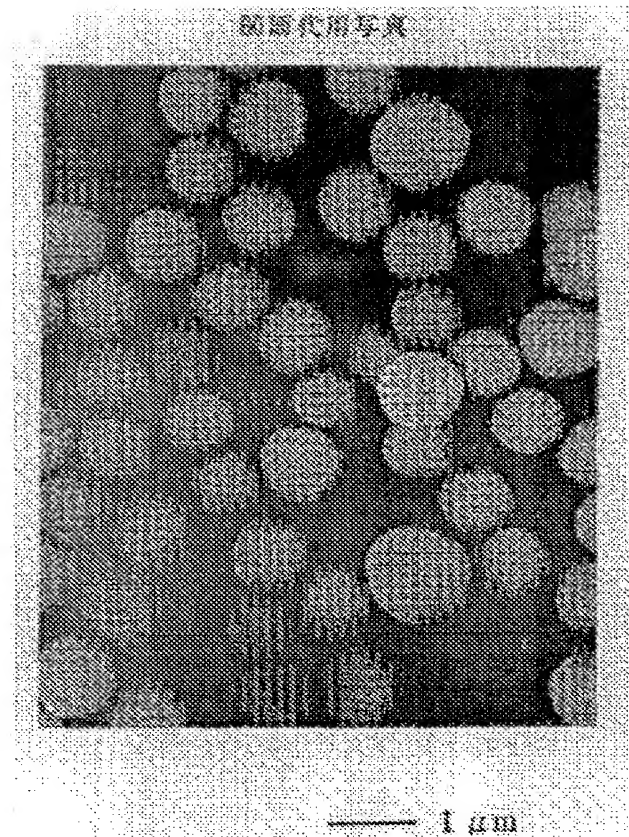
【図3】本発明の非晶質シリカ系定形粒子、シリカゲル及びゼオライトについて、RH50%における吸湿量と時間との関係をプロットしたグラフである。

【図2】

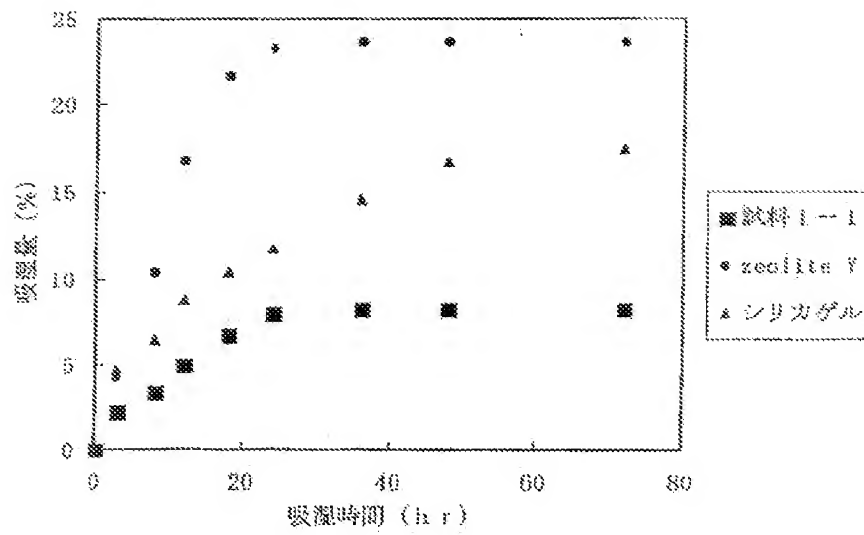


X線回折図

【図1】



【図3】



RH 50%に於ける吸湿量